

74310 Mikroelektroniikan pakkaustekniikka
prof. Eero Ristolainen

TENTTI 5.3.2001

Kirjallisuuden käyttö kielletty

1. Kerro lyhyesti mitä seuraavilla termeillä tarkoitetaan (yht. 6 p):
 - a) BGA
 - b) MCM
 - c) CSP
2. Mitä COB-tekniikka tarkoittaa? (6 p)
3. Passiivikomponenttien integrointi puolijohteelle. (6 p)
4. Anisotrooppisesti sähköäjohtavien liimojen käyttö flip chip -liittämisessä. (6 p)
5. Puolijohdekomponentin lämmönhallintamahdollisuudet. (6 p)